Partial English Translation of

₽

LAID OPEN unexamined

JAPANESE PATENT APPLICATION

Publication No. 09-219567

[0013] As shown in Figure 1, in the AlGaInP-based semiconductor laser according to the first embodiment, an n-type GaAs buffer layer 2, an n-type AlGaInP cladding layer 3, a non-doped AlGaInP layer 4, an active layer 5 formed of, for example, non-doped GaInP, a non-doped AlGaInP layer 6, a p-type AlGaInP cladding layer 7, a p-type GaInP contact layer 8, and a p-type GaAs cap layer 9 are sequentially formed on an n-type GaAs The upper part of the p-type AlGaInP cladding layer 7, the p-type GaInP contact layer 8 and the p-type GaAs cap layer 9 each have a striped pattern extending in one direction. Further, n-type GaAs current block layers 10 are formed on both sides of the upper part of the p-type AlGaInP cladding layer 7, the p-type GaInP contact layer 8 and the p-type GaAs cap layer 9 which have the striped pattern. Furthermore, a p-side electrode 11 such as a Ti/Pt/Au electrode is formed on the p-type GaAs cap layer 9 and the n-type GaAs current block layer 10 and an n-side electrode 12 such as an In electrode is formed on the reverse of the n-type GaAs substrate 1. In the first embodiment, a first part 7a of the p-type AlGaInP cladding layer 7, which is in contact with the non-doped AlGaInP layer 6, is lightly doped with a p-type impurity, Mg while a second part 7b, which is the rest of the p-type AlGaInP cladding layer 7, is heavily doped The first part 7a has a carrier concentration of, for example, approximately 1×10^{17} cm⁻³ and the second part 7b has a carrier concentration of, for example, approximately $5 \times 10^{17} \, \text{cm}^{-3}$.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-219567

(43)Date of publication of application: 19.08.1997

(51)Int.CI.

H01S 3/18 H01L 33/00

(21)Application number: 08-049552

(22)Date of filing:

13.02.1996

(71)Applicant : SONY CORP

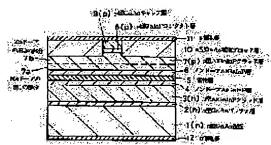
(72)Inventor: ISHIKAWA HIDETO

(54) SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To get favorable laser property and perform laser oscillation without hindrance by providing a p-type clad layer with a first section doped with Mg as p-type impurities, and a second section doped with Zn as p-type impurities.

SOLUTION: An n-type GaAs current block layer 10 is buried in a p-type GAInP contact layer 8 and a p-type GaAs cap layer 9, the upper parts of a p-type AIGAInP clad layer 7. A p-type electrode 11 is provided on the p-type GaAs cap layer 9 and the n-type GaAs current block layer 10, and an n-type GaAs substrate 1 is provided with an n-type electrode 12. A first section 7a in contact with a nondoped AIGaIn layer 6 is doped in low concentration with Mg of p-type impurities, and the second section 7b is doped in high concentration with Zn. By the above, favorable laser property can be obtained by effectively preventing the Zn in the p-type clad layer from penetrating into the active layer. Moreover, the series resistance can be made lower enough, whereby laser oscillation can be performed without hindrance.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.05.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application

converted registration].

abandonment

[Date of final disposal for application]

20.04.2005

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-219567

(43)公開日 平成9年(1997)8月19日

(51) Int.Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18 H01L 33/00 H01S 3/18

H01L 33/00

В

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平8-49552

(71)出顧人 000002185

ソニー株式会社

(22)出願日

平成8年(1996)2月13日

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 石川 秀人

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

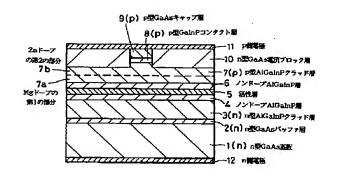
(74)代理人 弁理士 杉浦 正知

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ

(57)【要約】

【課題】 p型クラッド層中のZnが活性層中に入り込むのを有効に防止することができ、しかもp型クラッド層の直列抵抗を十分に低くすることができるAlGaInP系の半導体レーザを提供する。

【解決手段】 AlGaInP系の半導体レーザにおいて、p型AlGaInPクラッド層7のうちの活性層5側の第1の部分7aにp型不純物としてMgをドープし、残りの第2の部分7bにp型不純物としてZnをドープする。第1の部分7aにはMgに加えて非常に低濃度のZnをドープしてもよい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 活性層をn型クラッド層とp型クラッド 層とによりはさんだ構造を有するAIGaInP系の半 導体レーザにおいて、

上記p型クラッド層に上記活性層側から見て第1の部分 および第2の部分が順次設けられ、

上記第1の部分にp型不純物としてMgがドープされ、 上記第2の部分にp型不純物としてZnがドープされて いることを特徴とする半導体レーザ。

【請求項2】 上記p型クラッド層の上記第2の部分の 10 キャリア濃度は上記 p型クラッド層の上記第1の部分の キャリア濃度よりも高いことを特徴とする請求項1記載 の半導体レーザ。

【請求項3】 上記活性層と上記 n型クラッド層との間 および上記活性層と上記p型クラッド層との間に上記n 型クラッド層および上記p型クラッド層とほぼ同一組成 のノンドープ層がそれぞれ設けられていることを特徴と する請求項1記載の半導体レーザ。

【請求項4】 上記n型クラッド層、上記p型クラッド 層および上記ノンドープ層はそれぞれAlGaInPか 20 らなることを特徴とする請求項3記載の半導体レーザ。

【請求項5】 活性層をn型クラッド層とp型クラッド 層とによりはさんだ構造を有するAIGaInP系の半 導体レーザにおいて、

上記p型クラッド層に上記活性層側から見て第1の部分 および第2の部分が順次設けられ、

上記第1の部分にp型不純物としてMgおよびZnがド ープされ、上記第2の部分にp型不純物としてZnがド ープされていることを特徴とする半導体レーザ。

【請求項6】 上記p型クラッド層の上記第2の部分の 30 キャリア濃度は上記p型クラッド層の上記第1の部分の キャリア濃度よりも高いことを特徴とする請求項5記載 の半導体レーザ。

【請求項7】 上記活性層と上記 n型クラッド層との間 および上記活性層と上記p型クラッド層との間に上記n 型クラッド層および上記p型クラッド層とほぼ同一組成 のノンドープ層がそれぞれ設けられていることを特徴と する請求項5記載の半導体レーザ。

【請求項8】 上記n型クラッド層、上記p型クラッド 層および上記ノンドープ層はそれぞれAlGaInPか 40 らなることを特徴とする請求項7記載の半導体レーザ。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】この発明は、半導体レーザに 関し、特に、赤色発光のAlGalnP系の半導体レー ザに関する。

[0002]

【従来の技術】AlGaInP系半導体レーザは、赤色 発光の可視光半導体レーザとして注目されており、すで に実用化されている。従来、このAlGaInP系半導 50

体レーザの製造においては、n型不純物としてSe、p 型不純物としてZnが一般的に用いられている。しかし ながら、これらのSeおよびZnはいずれも比較的拡散 しやすいため、pn接合の位置を制御するのが容易であ るとは言い難い。特に、Znについては、AlGaIn P系材料の特徴として高濃度ドーピングが困難であるた め、AlGaInP層中に活性化されないZnが比較的 多く存在する。そして、このZnが活性層中に拡散によ り入り込み、レーザ特性の劣化を引き起こしやすいとい う問題があった。

【0003】そこで、この問題を解決するために、改良 が行われている。その一例を図3に示す。図3に示す従 来のAlGaInP系半導体レーザにおいては、n型G a A s 基板 1 0 1 上に、n型G a A s バッファ層 1 0 2、n型AlGaInPクラッド層103、ノンドープ AlGaInP層104、ノンドープGaInPからな る活性層105、ノンドープAlGaInP層106、 p型AlGaInPクラッド層107、p型GaInP コンタクト層108およびp型GaAsキャップ層10 9が、順次積層されている。ここで、p型AlGaIn Pクラッド層107の上層部、p型GaInPコンタク ト層108およびp型GaAsキャップ層109は一方 向に延びるストライプ形状を有する。また、このストラ イプ形状のp型AlGaInPクラッド層107の上層 部、p型GaInPコンタクト層108およびp型Ga Asキャップ層109の両側の部分にはn型GaAs電 流ブロック層110が埋め込まれている。そして、p型 GaAsキャップ層109およびn型GaAs電流ブロ ック層110上にp側電極111が設けられ、n型Ga As基板101の裏面にn側電極112が設けられてい

【0004】この場合、p型AlGaInPクラッド層 107と活性層105との間に設けられたノンドープA lGaInP層106により、p型AlGaInPクラ ッド層107中にp型不純物としてドープされた2nが 活性層105中に入り込むのが防止されている。また、 n型AlGaInPクラッド層103と活性層105と の間に設けられたノンドープAlGaInP層104に より、n型AlGaInPクラッド層103中にn型不 純物としてドープされたSeが活性層105中に入り込 むのが防止されている。なお、ノンドープAIGaIn P層104およびノンドープAlGaInP層106の 厚さの制御により、pn接合の位置が制御される。

【0005】しかしながら、上述の図3に示す従来のA 1GaInP系半導体レーザにおいては、活性層105 中へのZnの入り込みの防止は不十分であった。そこ で、図3に示すAlGaInP系半導体レーザを改良し たものとして、図4に示すようなAlGaInP系半導 体レーザが知られている(例えば、特開平6-1407 19号公報)。この図4に示すAlGaInP系半導体

.- .

レーザは、p型AlGaInPクラッド層107のうちのノンドープAlGaInP層106と接する第1の部分107aにはp型不純物としてZnが低濃度にドープされ、残りの第2の部分107bにはZnが高濃度にドープされていることが、図3に示すAlGaInP系半導体レーザと異なる。この場合には、p型AlGaInPクラッド層107のエピタキシャル成長時のZnのドーピングを低濃度と高濃度との二段階に分けて行うことによりpn接合の位置の制御性が高められるとともに、そのZnの高濃度層、すなわち第2の部分107bを活10性層105から十分に離すことができることによりこの活性層105中にZnが入り込むのが有効に防止されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の図4に示す従来のAlGaInP系半導体レーザのように、p型AlGaInPクラッド層107のうちのZnが高濃度にドープされた第2の部分107bを活性層105からできるだけ離そうとすると、p型AlGaInPクラッド層107の直列抵抗が高くなることにより、レーザ発振が起きにくくなってしまうという問題があった。したがって、この発明の目的は、p型クラッド層中のZnが活性層中に入り込むのを有効に防止することができることにより良好なレーザ特性を得ることができ、しかもp型クラッド層の直列抵抗を十分に低くすることができることによりレーザ発振を支障なく行わせることができるAlGaInP系の半導体レーザを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を 30 解決すべく鋭意検討を行った結果、p型クラッド層のうちの活性層側の部分の<math>p型不純物として、従来より用いられている <math>2nの代わりに、2n0元比べて化合物半導体の固体中で拡散しにくい2n0元り込みを防止するのに有効であることを見い出し、2n0元の発明を案出するに至った。ここで、2n16年度の2n2元とが確認されている。

【0008】すなわち、上記目的を達成するために、この発明の第1の発明は、活性層を n型クラッド層と p型クラッド層とによりはさんだ構造を有する AlGaln P系の半導体レーザにおいて、 p型クラッド層に活性層側から見て第1の部分および第2の部分が順次設けられ、第1の部分に p型不純物として Mgがドープされ、第2の部分に p型不純物として Znがドープされていることを特徴とするものである。

【0009】この発明の第2の発明は、活性層をn型クラッド層とp型クラッド層とによりはさんだ構造を有するAlGaInP系の半導体レーザにおいて、p型クラ 50

ッド層に活性層側から見て第1の部分および第2の部分が順次設けられ、第1の部分にp型不純物としてMgおよびZnがドープされ、第2の部分にp型不純物としてZnがドープされていることを特徴とするものである。【0010】この発明において、典型的には、p型クラッド層の第2の部分のキャリア濃度はp型クラッド層の第1の部分のキャリア濃度よりも高い。この発明において、典型的には、活性層中への不純物の入り込みの防止やpn接合の位置の制御のために、活性層とn型クラッド層との間および活性層とp型クラッド層との間にn型クラッド層およびp型クラッド層とほぼ同一組成のノンドープ層がそれぞれ設けられる。この発明において、典型的には、n型クラッド層、p型クラッド層およびノンドープ層はそれぞれAlGaInPからなる。

【0011】上述のように構成されたこの発明による半導体レーザにおいては、p型クラッド層の活性層側の第1の部分に2nがドープされていないか、または、2nがドープされる場合であっても非常に低濃度で済むことにより、p型クラッド層中の2nが活性層中に入り込むのを有効に防止することができる。また、p型クラッド層中の2nが活性層中に入り込むのを防止するためにp型クラッド層の第2の部分を活性層から過度に離す必要がないので、p型クラッド層の直列抵抗を十分に低くすることができる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、実施形態の全図において、同一または対応する部分には同一の符号を付す。図1は、この発明の第1の実施形態によるAlGaInP系半導体レーザを示す。

【0013】図1に示すように、この第1の実施形態に よるAlGaInP系半導体レーザにおいては、n型G aAs基板1上に、n型GaAsバッファ層2、n型A lGaInPクラッド層3、ノンドープAlGaInP 層4、例えばノンドープGaInPからなる活性層5、 ノンドープAIGaInP層6、p型AIGaInPク ラッド層7、p型GaInPコンタクト層8およびp型 GaAsキャップ層9が、順次積層されている。ここ で、p型AlGaInPクラッド層7の上層部、p型G aInPコンタクト層8およびp型GaAsキャップ層 9は一方向に延びるストライプ形状を有する。また、こ のストライプ形状のp型AlGaInPクラッド層7の 上層部、p型GaInPコンタクト層8およびp型Ga Asキャップ層9の両側の部分にはn型GaAs電流ブ ロック層10が埋め込まれている。そして、p型GaA sキャップ層9およびn型GaAs電流ブロック層10 上に例えばTi/Pt/Au電極のようなp側電極11 が設けられ、n型GaAs基板1の裏面に例えばIn電 極のようなn側電極12が設けられている。この第1の 実施形態においては、p型AlGaInPクラッド層7

のうちのノンドープAlGaInP層6と接する第1の 部分7aにはp型不純物としてMgが低濃度にドープさ れており、残りの第2の部分7 bには2 nが高濃度にド ープされている。ここで、第1の部分7aのキャリア濃 度は例えば1×10¹⁷c m⁻³程度、第2の部分7bのキ ャリア濃度は例えば5×10¹⁷ c m⁻³程度である。

【0014】次に、上述のように構成された第1の実施 形態によるAlGaInP系半導体レーザの製造方法に ついて説明する。すなわち、図1に示すように、まず、 n型GaAs基板1上に、例えば有機金属化学気相成長 (MOCVD) 法や分子線エピタキシー (MBE) 法に より、n型GaAsバッファ層2、n型AlGaInP クラッド層3、ノンドープAlGaInP層4、例えば ノンドープGaInPからなる活性層5、ノンドープA 1GaInP層6、p型AlGaInPクラッド層7、 p型GaInPコンタクト層8およびp型GaAsキャ ップ層 9 を順次エピタキシャル成長させる。ここで、p 型AlGaInPクラッド層7のエピタキシャル成長は 二段階に分けて行う。すなわち、第1段階においては、 p型不純物としてMgを用いてp型AlGaInPクラ ッド層7を所定厚さだけエピタキシャル成長させる。こ の第1段階においてエピタキシャル成長されたp型Al GaInPクラッド層7が上述の第1の部分7aを構成 する。次に、p型不純物としてZnを用いて残りのp型 AlGaInPクラッド層7をエピタキシャル成長させ る。この第2段階においてエピタキシャル成長された p 型AlGaInPクラッド層7が上述の第2の部分7b を構成する。

【0015】次に、p型GaAsキャップ層 9上にSi N膜やSiO₂ 膜からなるストライプ形状のマスク(図 30 示せず)を形成した後、このマスクをエッチングマスク として用いてp型AIGaInPクラッド層7の厚さ方 向の所定の深さまでエッチングする。これによって、p 型AlGaInPクラッド層7の上層部、p型GaIn Pコンタクト層 8 および p型G a A s キャップ層 9 がス トライプ形状にパターニングされる。次に、上述のマス クを成長マスクとして用いてn型GaAs電流ブロック 層10をエピタキシャル成長させて上述のストライプ部 の両側の部分を埋める。次に、上述のマスクをエッチン グ除去した後、p型GaAsキャップ層9およびn型G aAs電流ブロック層10上に真空蒸着法などによりp 側電極11を形成するとともに、n型GaAs基板1の 裏面に同様に真空蒸着法などにより n 側電極 1 2 を形成 する。以上により、目的とするAlGaInP系半導体 レーザが製造される。

【0016】以上のように、この第1の実施形態によれ ば、p型A1GaInPクラッド層7のうちの活性層5 側の第1の部分7aにはp型不純物として拡散しにくい Mgがドープされており、この第1の部分7aには拡散 しやすいZnはドープされていないので、p型AlGa 50

InPクラッド層7中のZnが活性層5中に入り込むの を有効に防止することができる。このため、良好なレー ザ特性を得ることができる。また、活性層5への2nの 入り込みを防止するためにp型AlGaInPクラッド 層7のうちの2nが高濃度にドープされた第2の部分7 bを活性層 5 から過度に離す必要がないので、p型A1 GaInPクラッド層7の直列抵抗をレーザ発振に支障 が生じない程度に十分に低くすることができる。

【0017】図2は、この発明の第2の実施形態による AlGaInP系半導体レーザを示す。図2に示すよう に、この第2の実施形態によるAlGaInP系半導体 レーザにおいては、p型AlGaInPクラッド層7の うちのノンドープAlGaInP層6と接する第1の部 分7aに、p型不純物として、MgおよびこのMgに比 べて非常に低濃度のZnがドープされている。その他の ことは、第1の実施形態によるAlGalnP系半導体 レーザと同様であるので、説明を省略する。この第2の 実施形態によれば、p型AlGaInPクラッド層7の うちの活性層5側の第1の部分7aにはp型不純物とし て拡散しにくいMgが主としてドープされ、拡散しやす いZnは非常に低濃度にしかドープされていないので、 第1の実施形態と同様に、p型AlGaInPクラッド 層7中のZnが活性層5中に入り込むのを有効に防止す。 ることができる。このため、良好なレーザ特性を得るこ とができる。また、p型AlGaInPクラッド層7の 直列抵抗をレーザ発振に支障が生じない程度に低くする ことができることも、第1の実施形態と同様である。こ れに加えて、この第2の実施形態によれば、p型A1G alnPクラッド層7の第1の部分7a中へのZnドー プ量の調整により、pn接合の位置をより高い制御性で 制御することができる。

【0018】以上、この発明の実施形態について具体的 に説明したが、この発明は、上述の実施形態に限定され るものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の 変形が可能である。例えば、上述の第1の実施形態およ び第2の実施形態においては、ノンドープGaInPか らなる活性層5を用いているが、活性層5の材料として は例えばノンドープAlGaInPを用いてもよい。ま た、上述の第1の実施形態および第2の実施形態におい て用いた電流狭窄構造と異なる電流狭窄構造を用いても よく、さらには場合によっては電流狭窄構造を用いない でもよい。さらに、上述の第1の実施形態および第2の 実施形態においては、この発明をDH (Double Heteros tructure) 構造のAlGaInP系半導体レーザに適用 した場合について説明したが、この発明は、SCH(Se parate Confinement Heterostructure) 構造のAlGa InP系半導体レーザや、歪超格子を活性層としたA1 GaInP系半導体レーザに適用してもよい。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、この発明による半

導体レーザによれば、p型クラッド層のうちの活性層側 の第1の部分にはMgがドープされているので、また、 この第1の部分にMgおよびZnがドープされる場合で あってもこのZnは非常に低濃度で済むので、p型クラ ッド層中のZnが活性層中に入り込むのを有効に防止す ることができる。これによって、良好なレーザ特性を得 ることができる。また、p型クラッド層中のZnが活性 層中に入り込むのを防止するためにp型クラッド層の第 2の部分を活性層から過度に離す必要がないので、p型 クラッド層の直列抵抗を十分に低くすることができ、こ 10 Pクラッド層、4、6・・・ノンドープA1GalnP れによってレーザ発振を支障なく行わせることができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施形態によるAlGaIn

P系半導体レーザを示す断面図である。

【図2】この発明の第2の実施形態によるAlGaIn P系半導体レーザを示す断面図である。

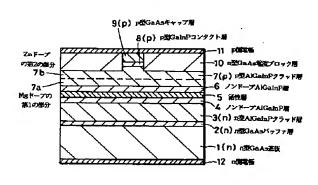
【図3】従来のAlGaInP系半導体レーザを示す断 面図である。

【図4】従来の他のAlGaInP系半導体レーザを示 す断面図である。

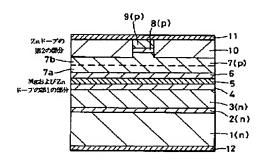
【符号の説明】

1···n型GaAs基板、3···n型AlGaIn 層、5・・・活性層、7・・・p型AlGaInPクラ ッド層、7a・・・第1の部分、7b・・・第2の部 分、9・・・p型GaAsキャップ層、10・・・n型 GaAs電流ブロック層

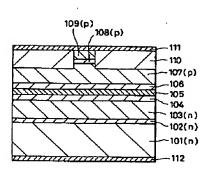
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

